

证券代码：300782

证券简称：卓胜微

江苏卓胜微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	参会单位：（以下排名不分先后） 民生加银基金、长信基金、前海开源基金、国融基金、汇丰晋信基金、招商基金、国海富兰克林基金、东兴基金、方正富邦基金、九泰基金、长盛基金、博时基金、富国基金、太平基金、融通基金、嘉实基金、中邮创业基金、东方阿尔法基金、银华基金、长安基金、摩根士丹利基金、华福证券、上海证券、红塔证券、长城证券、开源证券、国盛证券、东兴证券、东亚前海证券、华泰证券、西部证券、西南证券、华创证券、东方财富证券、汇丰前海证券、东吴证券、财通证券、国信证券、国元证券、东海证券、华西证券、中天国富、爱建证券、中航证券、摩根大通证券、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券、光大证券、方正证券、山西证券、中国银河证券、瑞银证券、华金证券、中邮证券、国海证券、国金证券、广发证券、野村东方国际证券、中信建投证券、中泰国际资管、宏利投资、交银国际资管、文渊资管、摩根证券投资信托、瑞银资管、博裕资本投资、中信保诚资管、长城财富保险资管、招商信诺资管、泰康资管、中华联合保险、华安财保资管、昆仑健康保险、中国人民保险、幸福人寿保险、国华兴益保险资管、大家资管等
时间	2025年3月31日
地点	公司会议室

上市公司接待人员姓名	<p>董事长、总经理：许志翰</p> <p>董事会秘书：刘丽琼</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、简要介绍公司 2024 年年度经营业绩情况</p> <p>2024 年度，公司持续推动集设计、研发、工艺、器件、材料等一体化的资源整合能力，并力求突破传统晶圆制造技术平台限制，聚焦特色工艺能力建设，打造差异化竞争优势。</p> <p>2024 年度，公司实现营业总收入 44.87 亿元，较上年同期增长 2.48%；归属于上市公司股东的净利润 4.02 亿元，较上年同期下降 64.20%。2024 年度，公司整体毛利率 39.49%，同比下降 6.96%。主要原因为受到越趋激烈的竞争环境、前期对于芯卓产线固定资产投入后折旧费用增加等影响。</p> <p>公司射频前端模组收入比例持续增长，销售占比从上年度的 36.34% 提升至 42.05%，射频模组的占比从 2020 年度的不足 10% 至 2024 年度的 42.05%，也充分彰显了不同应用终端对高性能、集成化模组的需求。预计后续随着模组产品的持续市场化推进，模组占比仍将继续提升。</p> <p>二、在问答环节，主要回复如下：</p> <p>1、请问公司目前的研发投入情况以及未来的研发投入趋势？</p> <p>A：尊敬的投资者，您好！公司始终聚焦在主业的高质量发展，围绕芯卓产业化的战略资源布局策略，持续强化公司研发、工艺相结合的技术能力。2024 年度公司研发投入 9.97 亿元，占营业收入比例的 22.22%，较上年同期增长 58.53%。公司芯卓自建产线导入大批量产品时会产生相应模具费，同时公司不断加强制造工艺和技术人才队伍的建设，使得公司研发费用大幅度增长，也体现了公司积极推动产品落地的效率。</p> <p>未来，随着产品的陆续导入芯卓产线，公司将持续积极投入研发创新与资源布局，专注提高核心技术竞争力。感谢您对公司的关注！</p> <p>2、请问公司 12 寸进展及未来的规划？</p> <p>A：尊敬的投资者，您好！公司全面开拓并发挥资源平台的深层效益，使 12 英寸 IPD 平台正式进入规模量产阶段，L-PAMiF、LFEM 等相关模组产品已全部采用自产 IPD 滤波器。公司 12 英寸射频开关和射频低噪声放大器的第一代工艺生产线已实现工艺通线进入量产阶段。同时公司启动了第二代工艺的开发，目前进展顺利。公司 12 英寸射频开关和射频低噪声放大器的工艺生产线产品已分别在射频开关、射频低噪声放大器及相应模组集成，覆盖多家品牌客户以及绝大部分 ODM 客户。</p>

截至 2024 年度末，公司 12 英寸晶圆生产线重要工艺实现从工艺稳定定型至具备量产能力，目前可实现 5000 片/月的产能规模。感谢您对公司的关注！

3、近几年，市场涌现 AI 技术创新，请问公司如何看待目前 AI 产业趋势及短期对下游市场展望？

A: 尊敬的投资者，您好！公司的射频前端芯片和模组、WiFi 连接模组、蓝牙前端模组等产品可应用于 AI 手机、智能穿戴、智能家居、蓝牙耳机、VR/AR 设备等领域。AI 技术的持续发展和演进将会重新定义智能化硬件，预计未来会有大量新产品和芯片需求，这将催生对工艺、性能和效率等创新的新要求。尤其是对于具备 AI 功能的可穿戴或智能家居等领域来说，低功耗互联技术成为关键。公司也将持续关注人工智能带来的市场机会和发展动态，结合公司的技术储备情况，根据客户的需求和市场变化开发相应的技术和产品。

短期来看，下游终端手机市场呈现季节性波动，上半年为淡季。随着手机品牌厂商持续对 AI 技术和产品深度融合，预计下半年需求较旺。整体而言，公司对整体营收业绩增长有信心。感谢您对公司的关注！

4、请问低轨卫星技术对于射频前端芯片产品的影响如何？

A: 尊敬的投资者，您好！目前公司射频前端产品可应用于卫星通信终端。未来随着卫星通信技术的发展，可能会对射频前端器件的数量和复杂度带来影响。公司会持续关注行业的发展动态，结合技术储备情况，根据客户的需求和市场变化及时推出相应的技术和产品。感谢您对公司的关注！

5、请问公司未来的转固节奏和折旧趋势如何？

A: 尊敬的投资者，您好！2024 年公司固定资产折旧变动金额约为 5.69 亿元。随着公司芯卓半导体产业化建设项目的持续推进，未来折旧费用仍会有所增加。

公司将视下游市场的变化保障产线供应能力并对设备进行相应转固。预计 2025 年的折旧增加额将有所减少。感谢您对公司的关注！

6、请问公司对 6 英寸晶圆生产线的进展与规划如何？

A: 尊敬的投资者，您好！目前 6 英寸滤波器产线的产品品类已实现全面布局，具备双工器/四工器、单芯片多频段滤波器等分立器件的规模量产能力，同时集成自产滤波器的 DiFEM、L-DiFEM、GPS 模组等产品成功导入多家品牌客户并持续放量。同时，公司 6 英寸滤波器产品积极进入分立滤波器市场，以市场份额优先的方式推动战略迁移。

芯卓资源平台实现的供应、生产制造、工艺等能力成功在 6 英寸滤波

器晶圆生产线上得到体现，产品良率稳中有进、国产化方案全面推进、工艺流程与操作规范进一步优化、自动化率达到行业头部水平。

未来，公司将会持续推进 6 英寸晶圆生产线的生产制造实力，在工艺上全面的积累和提升，迅速适应市场需求的变化和技术发展趋势，加强覆盖低、中、高端全类型的产品形态，以交付高质量、高良率、高性能的产品满足客户的多元化、差异化的需求，覆盖更广泛的市场群体。感谢您对公司的关注！

7、请问公司滤波器的专利问题，是否会对公司造成影响？

A: 尊敬的投资者，您好！作为国内射频前端领域的创新企业，公司始终坚持自主研发和合法合规经营，持续提升核心技术实力，始终尊重并高度重视知识产权保护。

公司于 2024 年 7 月发出对株式会社村田制作所“弹性波装置”专利的无效请求，该专利涉及公司高端滤波器 MAX-SAW 的 POI 衬底材料。国家知识产权局已于 2025 年 1 月 23 日发布《无效宣告请求审查决定书》（第 584544 号），正式宣告“弹性波装置”（专利号：ZL201610512603.9）专利权全部无效。MAX-SAW 滤波器作为公司重点技术和产品之一，此次专利无效宣告成果稳固支撑了公司 MAX-SAW 技术发展路径，有利于进一步巩固公司在 SAW 滤波器领域的技术布局和市场竞争优势。

未来，公司将持续加强针对关键技术和工艺加强专利保护措施，构建自身技术壁垒，形成公司满足客户差异化需求、开拓模组新市场的重要支撑。感谢您对公司的关注！

8、请问公司 WiFi 连接模组的进展和展望如何？

A: 尊敬的投资者，您好！公司积极推进在无线连接方面的技术研发，建立线性功率放大器技术平台。截至 2024 年末，公司在手机 WiFi FEM 中取得进展，WiFi7 模组产品已成功实现规模量产。

未来，公司将加强 WiFi7 模组产品的市场推广，推动公司在射频领域的技术延伸，进一步提升公司的研发创新能力和市场竞争力，力争成为主流的 WiFi7 模组供应商。感谢您对公司的关注！

9、请问目前公司短距通信感知芯片的进展如何？

A: 尊敬的投资者，您好！公司积极打造基于短距通信感知一体的 SoC 芯片技术体系，目前低功耗蓝牙系统产品持续迭代、超宽带 UWB 进入研发测试阶段，旨在形成短距离通信感知的系统解决方案和能力，在未来力开拓展到 IoT、智能家居等应用场景。感谢您对公司的关注！

10、请问在公司未来的发展过程中，产品的供应链是否会出现不利因素？

	<p>A: 尊敬的投资者，您好！公司立足产业发展趋势及公司发展战略，积极构建了高度自主可控的供应链体系，通过垂直整合与战略合作相结合的方式，确保产品供应的长期稳定性与可持续性。通过自建芯卓产线，使公司参与关键产品的芯片设计、工艺制造和封装测试一体化环节，将产品设计与工艺研发深度结合，形成自主的生产工艺支持，满足差异化需求，打造更具市场竞争力的产品的同时，实现了长期稳定自主可控的供给能力。</p> <p>随着对资源平台的投入，供应链体系在不断的磨合与优化中持续全面完善，公司逐渐具备了应对短期性、应急性问题的能力，增强供应链韧性，更使得整个体系具备了供应链循环的内生动力，让供应可靠性日益显著，为持续发展提供坚实的保障。未来公司会持续关注国际供应链的不确定性，也会积极应对供应链不稳定的情况，采取多维度策略来增强抗风险能力。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2025年3月31日